

平成27年3月期（第13期） 決算説明会

平成27年5月22日
株式会社ジーダット

1.平成27年3月期 決算概要

2.平成28年3月期 計画・業績予想

平成27年 3 月期のポイント

売上高:15.1億円(対前年比10.4%増)
営業利益:1.2億円(58.7%増)、経常利益:1.8億円(43.1%増)

ソリューション・ビジネスが大幅に伸長

拡張した代理販売品も売上高に貢献

研究開発案件の「取捨選択」により固定費増を抑制

平成27年 3 月期業績概要 (連結P/L)

(単位：百万円)

	平成26年 3 月期		平成27年 3 月期		
	実績	売上高比	実績	売上高比	対前年同期比
売上高	1,376	100.0%	1,519	100.0%	+10.4%
売上総利益	1,068	77.6%	1,065	70.2%	△0.3%
販売費及び一般管理費	989	71.9%	939	61.9%	△5.0%
営業利益	79	5.8%	125	8.3%	+58.7%
経常利益	128	9.3%	183	12.1%	+43.1%
当期純利益	104	7.6%	211	13.9%	+102.0%

種目別売上高の区分変更について

ソリューション・ビジネスの売上高拡大に伴い、種目別売上高の区分を変更いたしました。

変更前

製品及び商品

保守サービス



変更後

製品及び商品

- EDA製品及び商品の販売

保守サービス

- EDA製品に関するバージョンアップ品の提供
- 顧客における立ち上げ・運用の支援

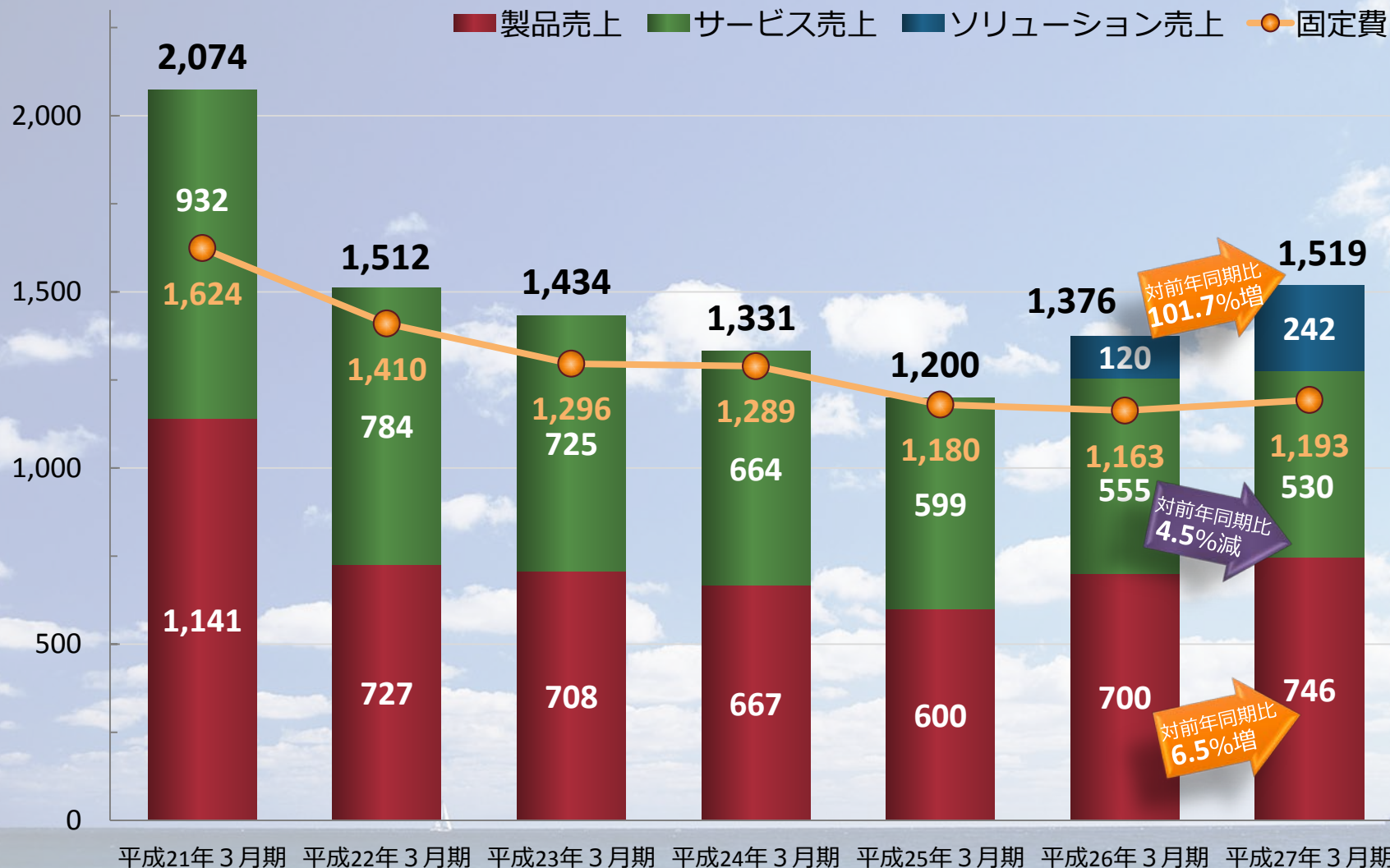
ソリューション

- カスタムソフトウェア受託開発
- 半導体設計受託
- EDAアウトソーシング

本資料中の平成26年3月期の売上は、変更後の区分に組み替えて比較しております。

売上高・固定費の推移

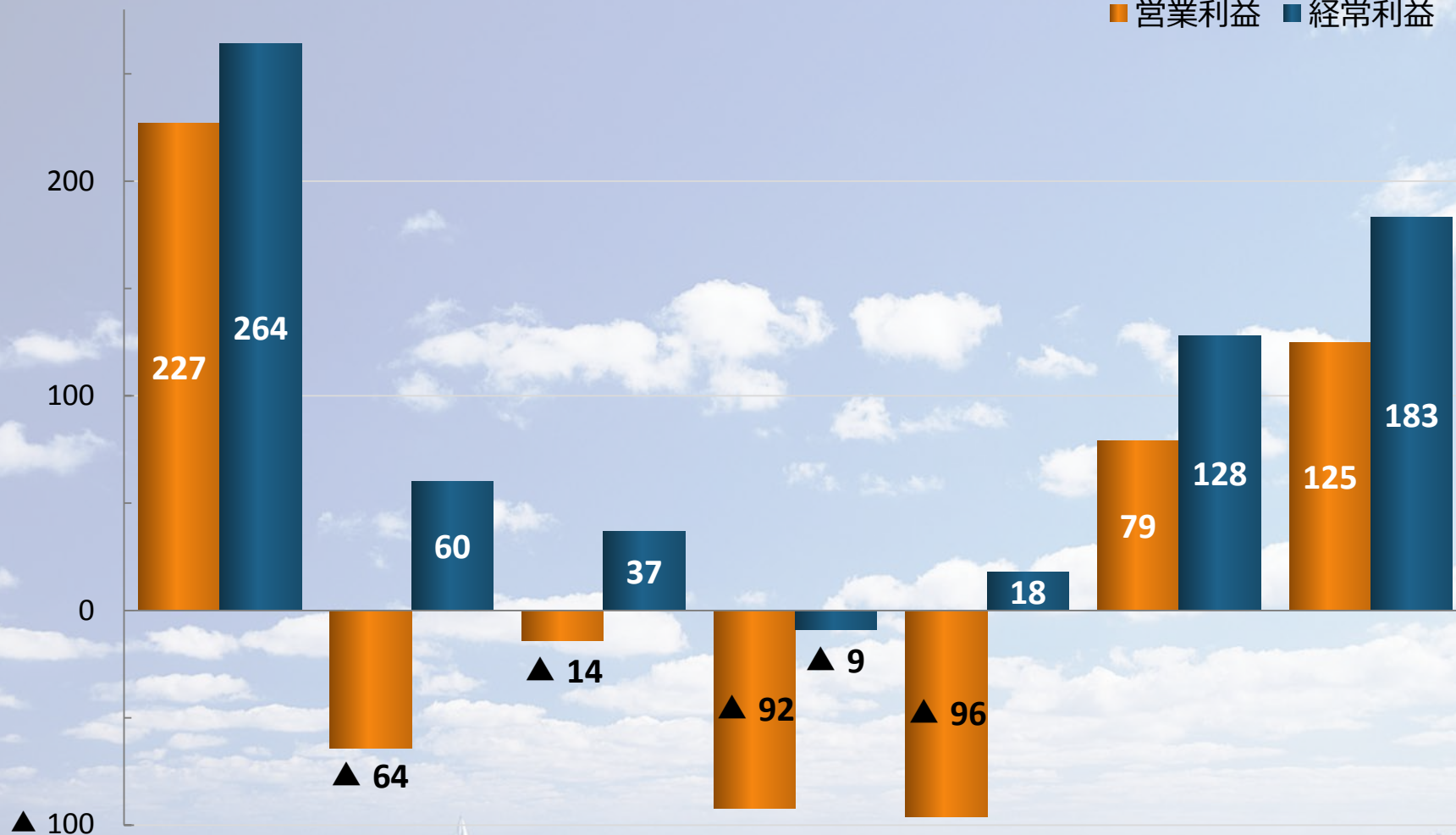
(単位：百万円)



利益の推移

(単位：百万円)

■ 営業利益 ■ 経常利益

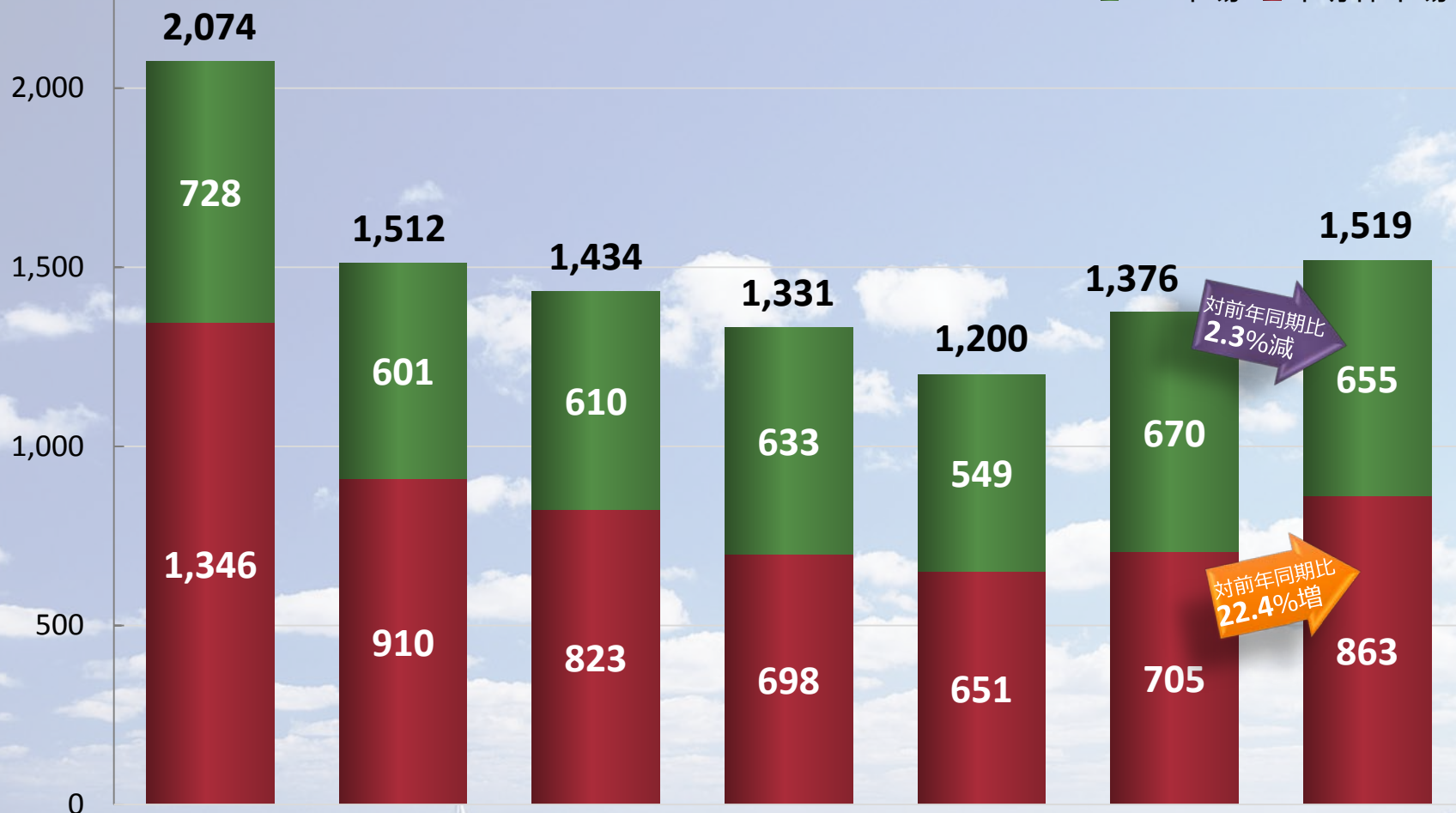


平成21年 3 月期 平成22年 3 月期 平成23年 3 月期 平成24年 3 月期 平成25年 3 月期 平成26年 3 月期 平成27年 3 月期

市場別売上高（半導体/FPD）

（単位：百万円）

■ FPD市場 ■ 半導体市場



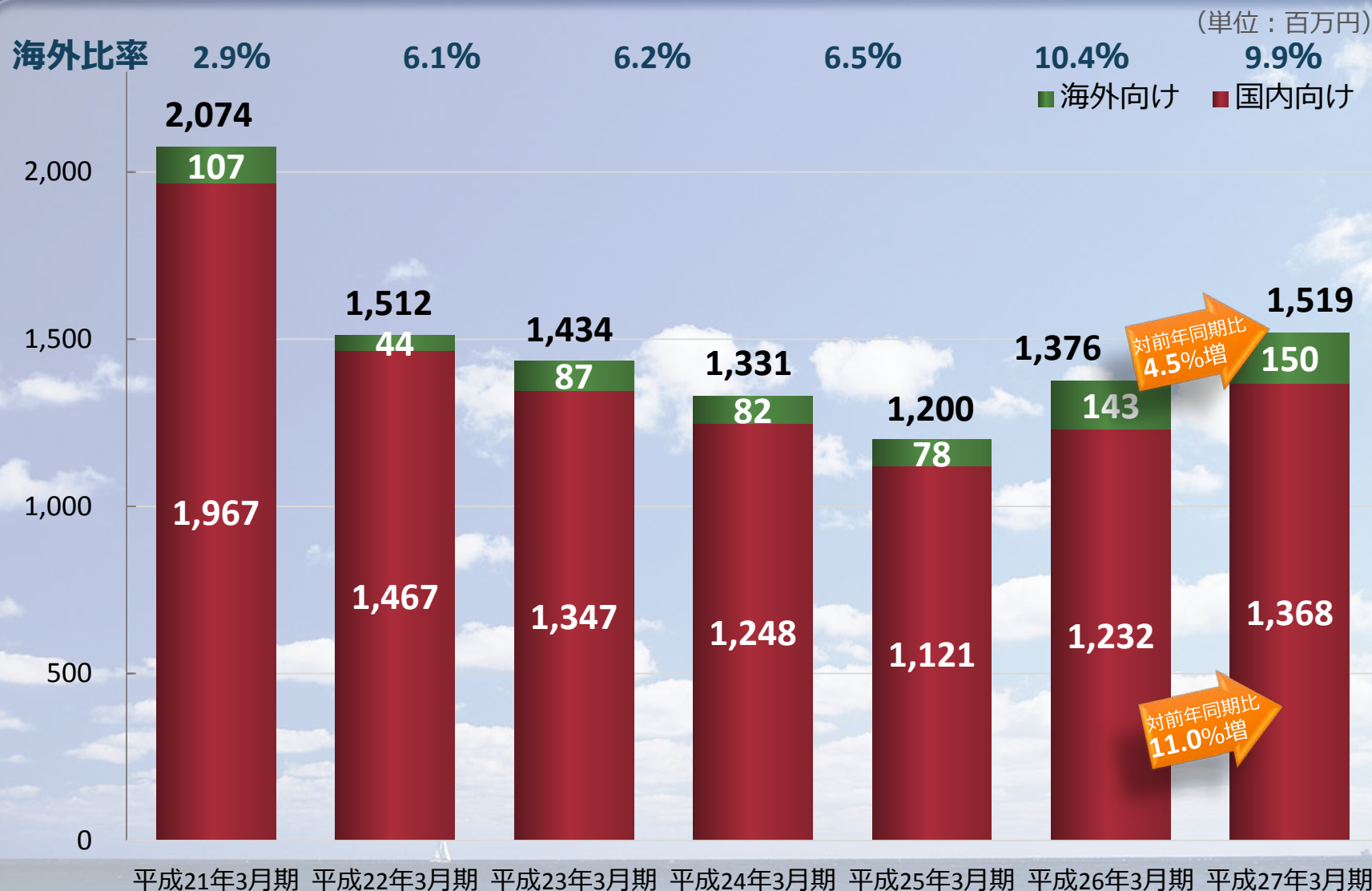
平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期

製品区分別売上高（自社開発/代理販売）

（単位：百万円）

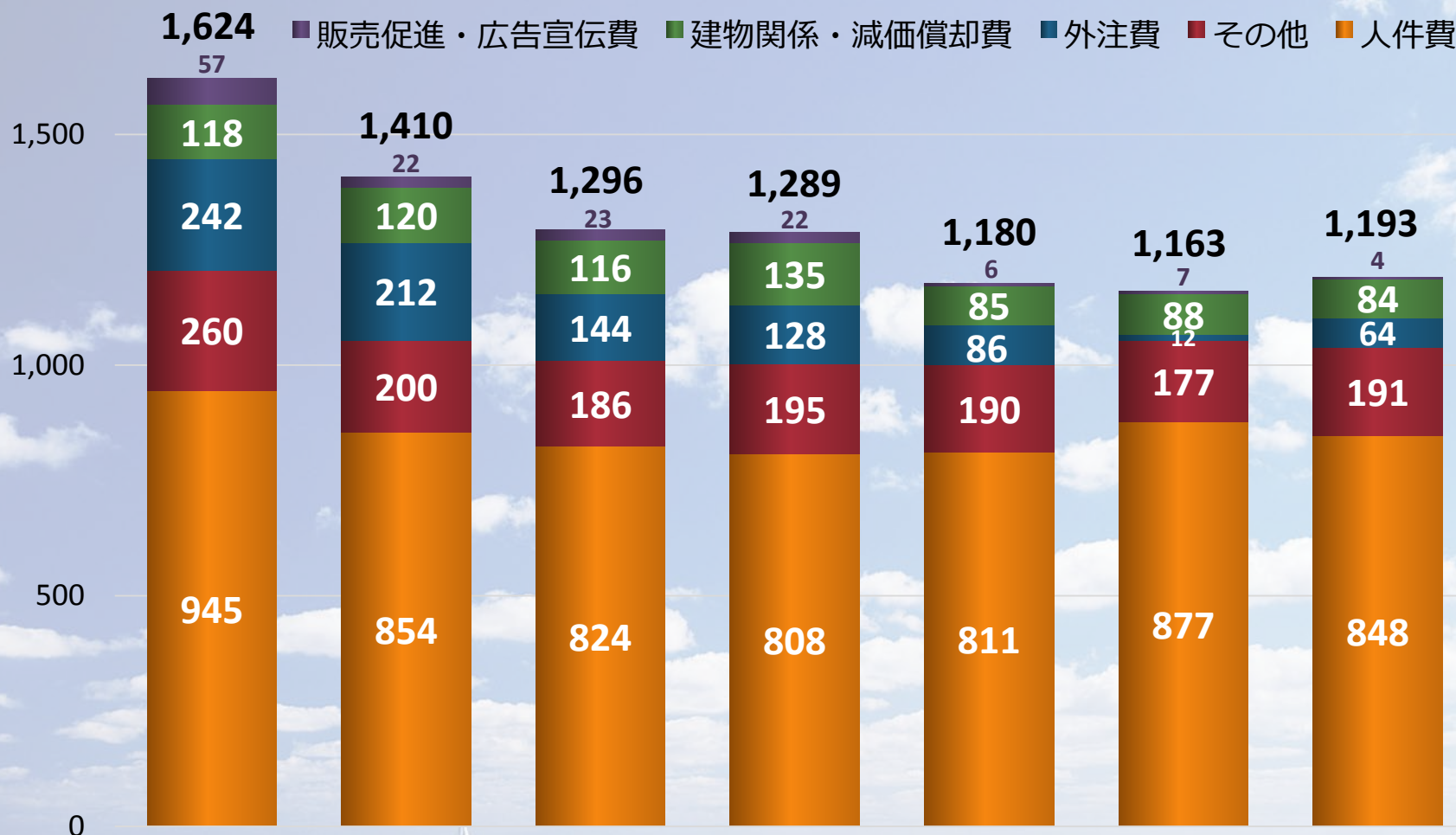


販売先別売上高（国内/海外）



固定費内訳

(単位：百万円)



平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期

連結貸借対照表

(単位：百万円)

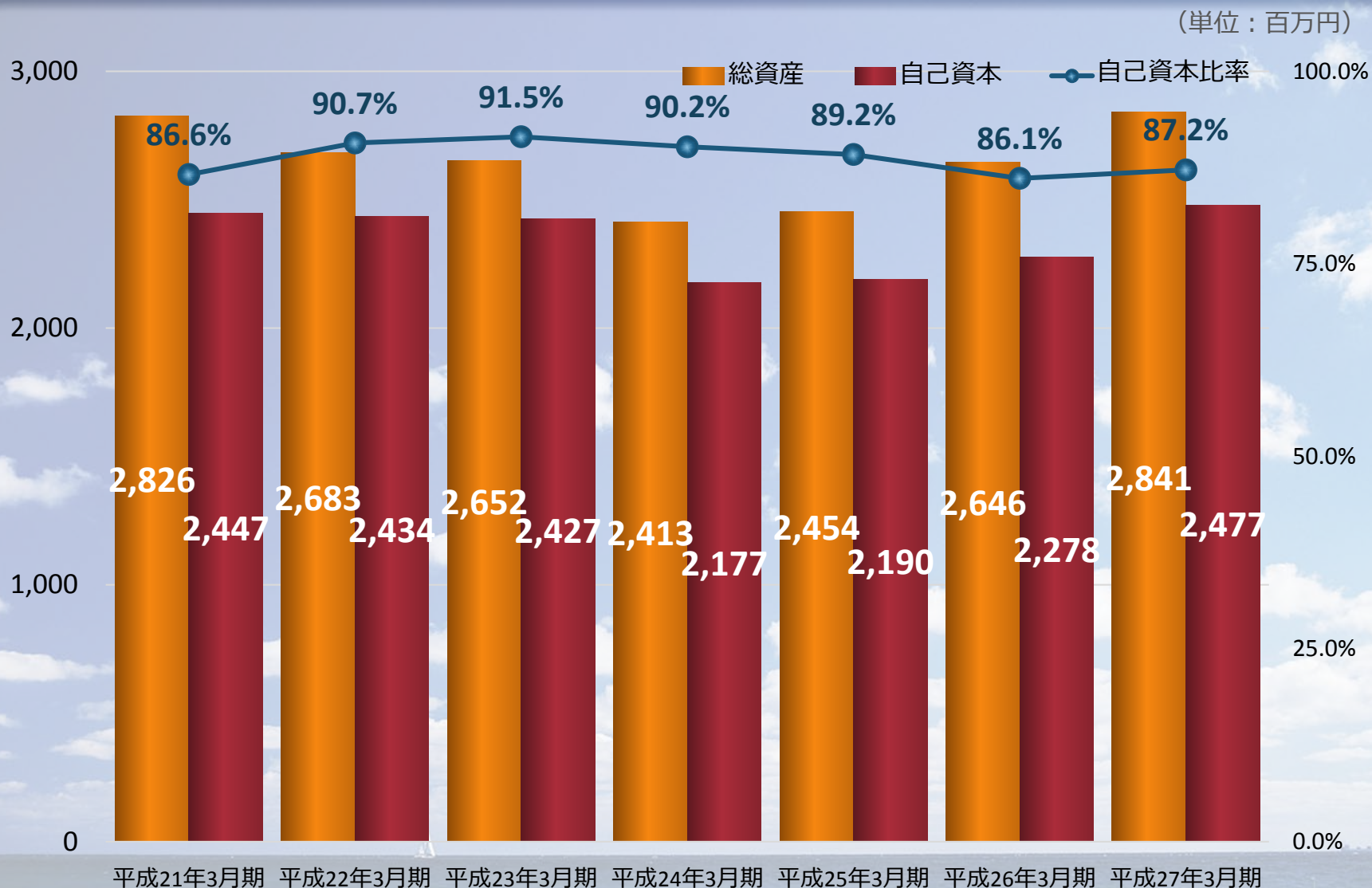
	平成26年 3月期末	平成27年 3月期末	差異		平成26年 3月期末	平成27年 3月期末	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産	2,083	2,257	173	I 流動負債	320	326	5
1 現金及び預金	1,819	1,918	98	1 買掛金	37	48	10
2 受取手形及び売掛金	124	218	94	2 未払法人税等	18	12	△5
3 電子記録債権	72	28	△44	3 賞与引当金	64	73	8
4 有価証券	—	—	—	4 その他	200	192	△8
5 たな卸資産	28	25	△2	負債合計	320	326	5
6 繰延税金資産	—	26	26	(純資産の部)			
7 その他	38	39	0	I 株主資本	2,278	2,470	192
				1 資本金	760	760	—
II 固定資産	562	584	22	2 資本剰余金	890	890	—
1 有形固定資産	23	27	4	3 利益剰余金	660	852	192
2 無形固定資産	19	20	1	4 自己株式	△32	△32	0
3 投資その他の資産合計	520	537	16	II 評価・換算差額等	0	7	6
投資有価証券	500	515	15	為替換算調整勘定	0	7	6
その他	20	21	1	II 少数株主持分	47	37	△9
				純資産合計	2,326	2,515	189
資産合計	2,646	2,841		負債純資産合計	2,646	2,841	195

連結キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

	平成26年 3月期末	平成27年 3月期末	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	121	151	29
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△340	△46	294
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	46	△19	△65
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	8	13	5
V 現金及び現金同等物の増減額	△164	98	263
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,084	919	△164
その他の現金及び現金同等物の増減額	—	—	—
VII 現金及び現金同等物の期末残高	919	1,018	98

総資産・自己資本



- ◆ **新製品(アナログ合成ツール)構想を発表**
 - **米国学会・展示会(DAC)に出展**
- ◆ **九州デザインセンター(福岡・熊本)の設立**
 - **半導体設計受託事業の本格開始**
 - **海外(アジア圏)サポート力の強化**
- ◆ **新製品(アナログ合成ツール)完成を発表**
 - **平成28年3月期に販売開始**
- ◆ **上海の販売子会社(AJM)の譲渡を決定**

1.平成27年3月期 決算概要

2.平成28年3月期 計画・業績予想

売上高:16.5億円(対前年比8.6%増)
営業利益:1.5億円(対前年比19.3%増)

製品企画体制の強化

ソリューション・ビジネスの更なる拡張

海外販売力の強化

平成28年 3 月期業績概要（連結P/L）

（単位：百万円）

	平成27年 3 月期		平成28年 3 月期		
	実績	売上高比	予想	売上高比	対前年同期比
売上高	1,519	100.0%	1,650	100.0%	+8.6%
売上総利益	1,065	70.2%	1,144	69.4%	+7.4%
販売費及び一般管理費	939	61.9%	994	60.3%	+5.8%
営業利益	125	8.3%	150	9.1%	+19.3%
経常利益	183	12.1%	170	10.3%	△7.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	211	13.9%	81	5.0%	△61.2%

電子部品業界は概ね回復基調



一部主要企業で再編・リストラを実施



国内EDA市場の縮小傾向は継続中

課
題

製品企画体制の強化

ソリューション・ビジネスの拡大

海外向け販売力の強化

◆ 自社開発製品の企画/開発力を強化

- 新開発製品の完成 ⇒ 営業活動を開始
 - 最先端向けアナログ合成ツール(RVT)のリリース
- 製品企画体制(PDCAサイクル)の整備
 - 主力製品の大幅刷新
 - 半導体・液晶向け新検証環境の構築

◆ ソリューション・ビジネスの拡大

- 半導体設計受託事業の拡大
 - 熊本事業所の半導体設計者を大幅増員
 - 半導体レイアウト設計の受託を開始
- EDAアウトソーシング事業の本格始動
 - 各種管理ツールを中核とした営業展開

◆海外向け製品販売力の強化

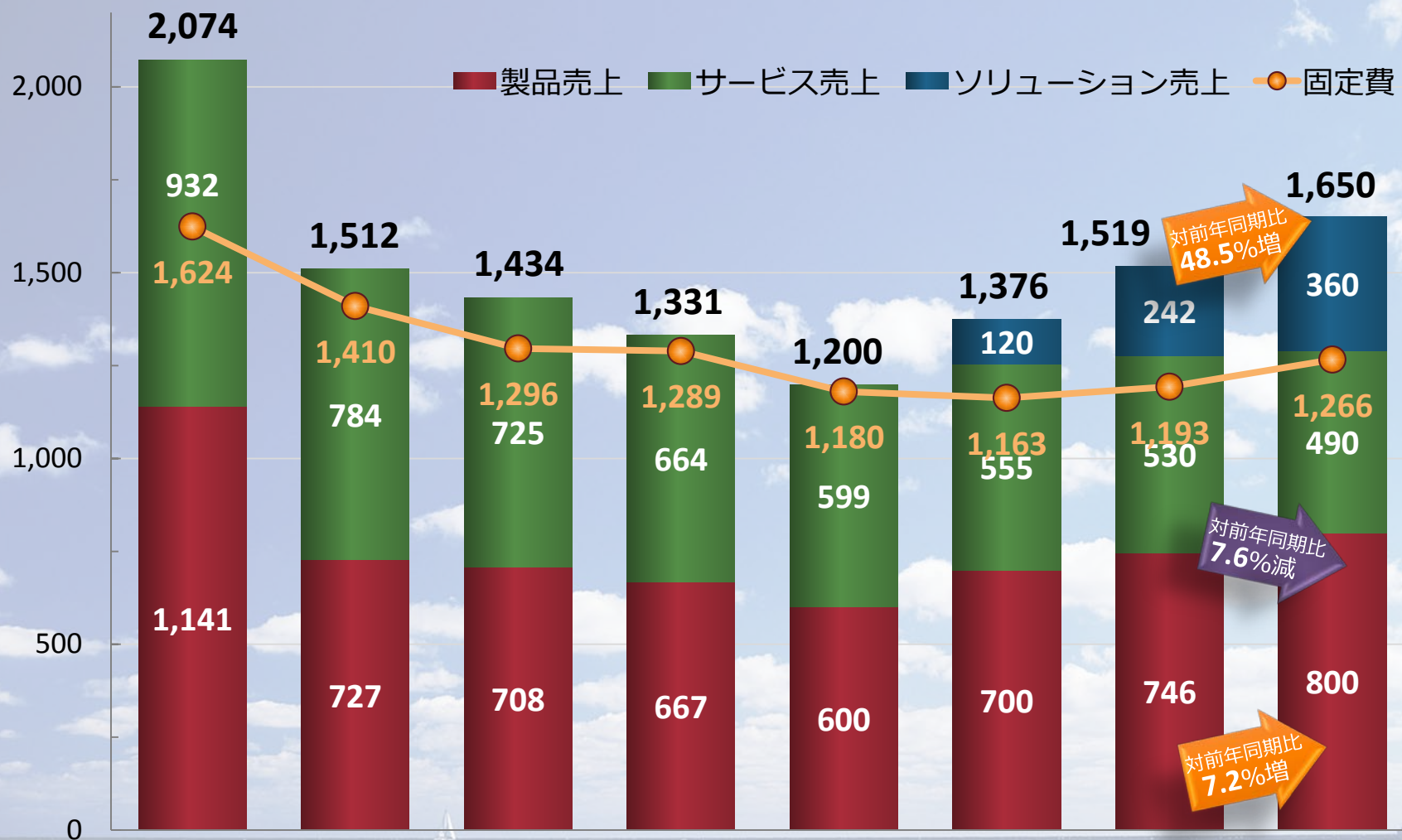
- 検査装置連携ソリューションの海外展開
 - マスク検査、故障検出・診断関連システム
- 複数代理店により顧客分野を拡大
 - 米国、台湾、中国
- 福岡事業所による海外顧客の重点サポート
 - 中国、台湾、韓国

◆新分野ビジネスへの挑戦

- 新規ビジネスのテストマーケティングを開始
- 国内外の最新情報収集体制を確立

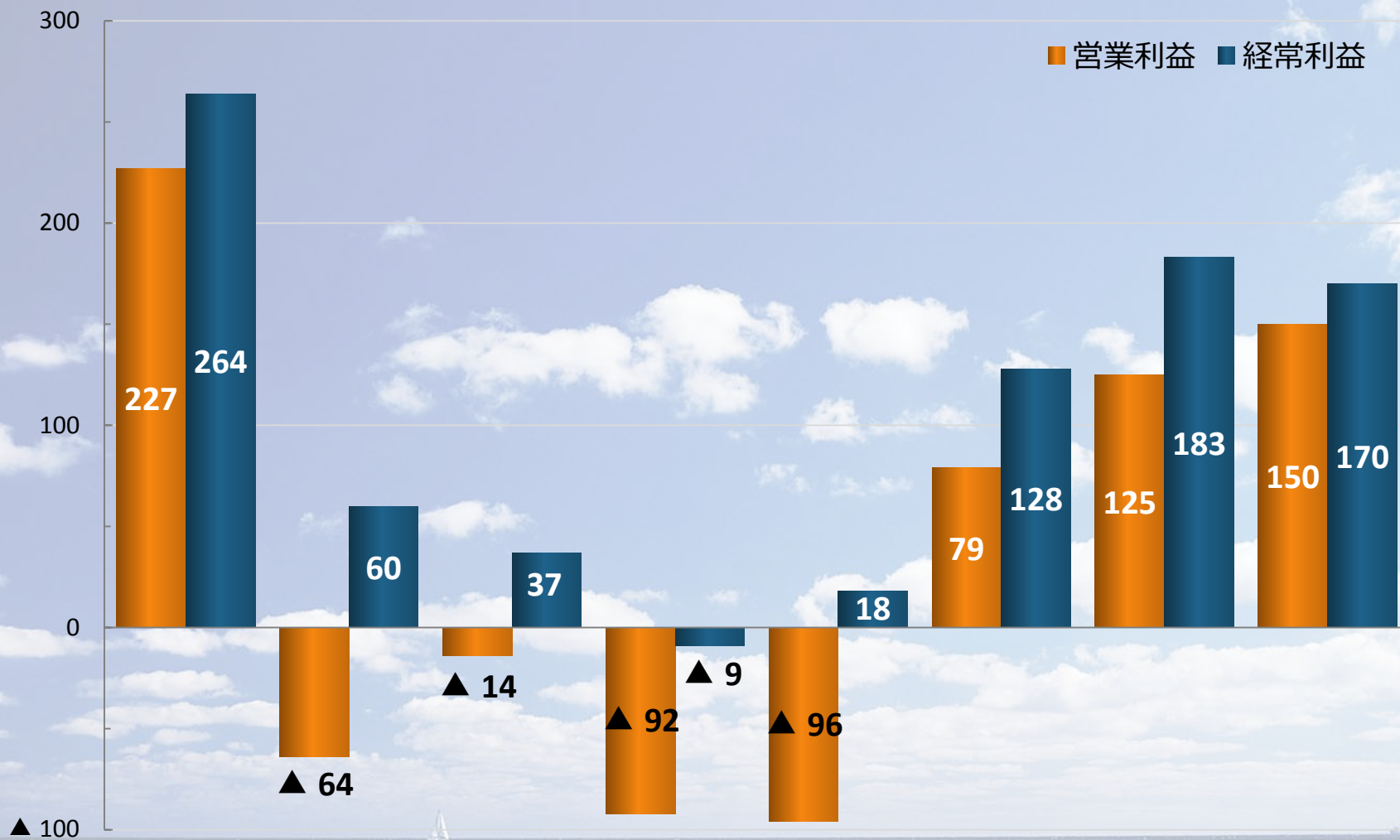
売上高・固定費

(単位：百万円)



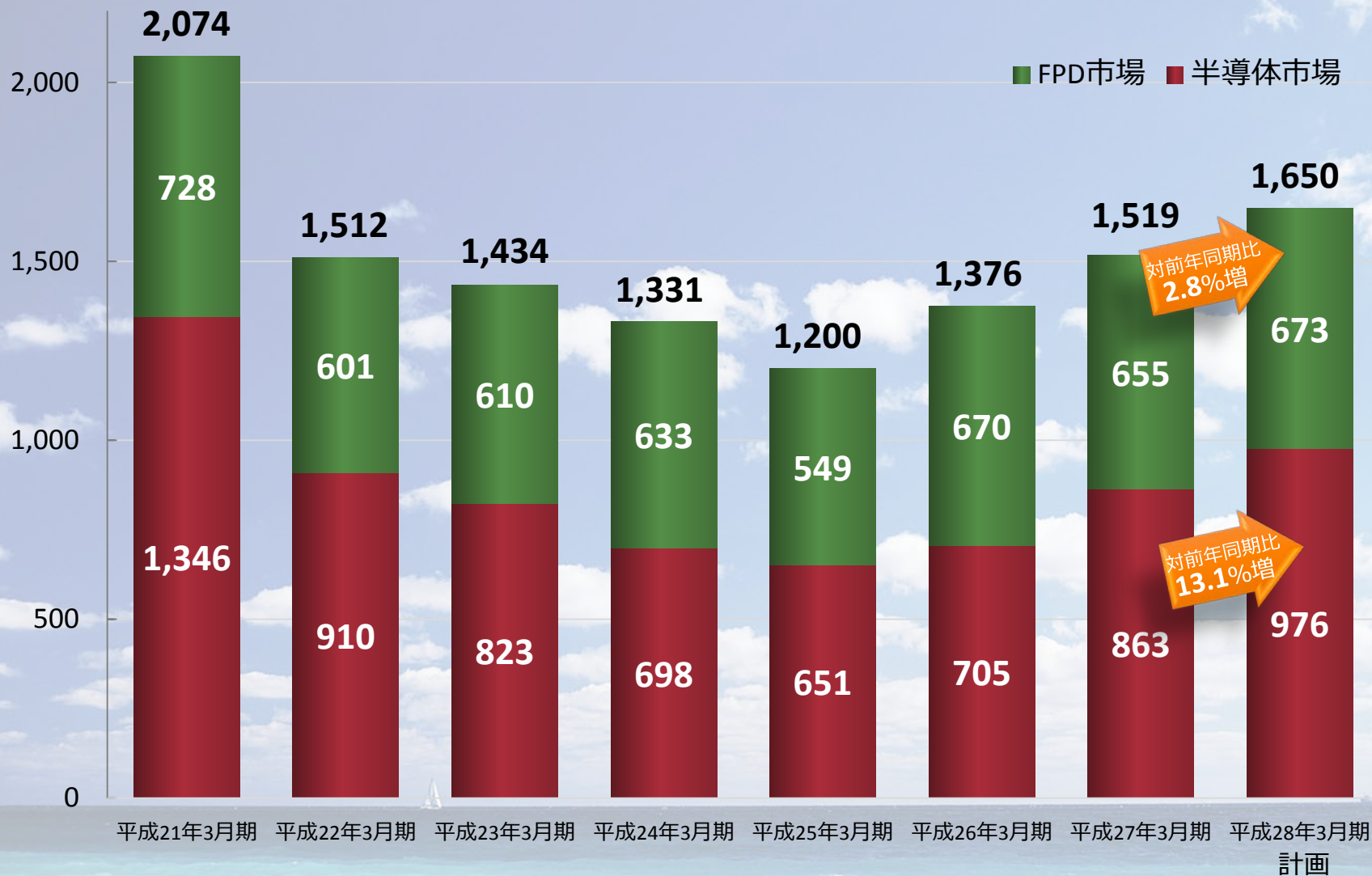
平成21年 3月期 平成22年 3月期 平成23年 3月期 平成24年 3月期 平成25年 3月期 平成26年 3月期 平成27年 3月期 平成28年 3月期
計画

(単位：百万円)

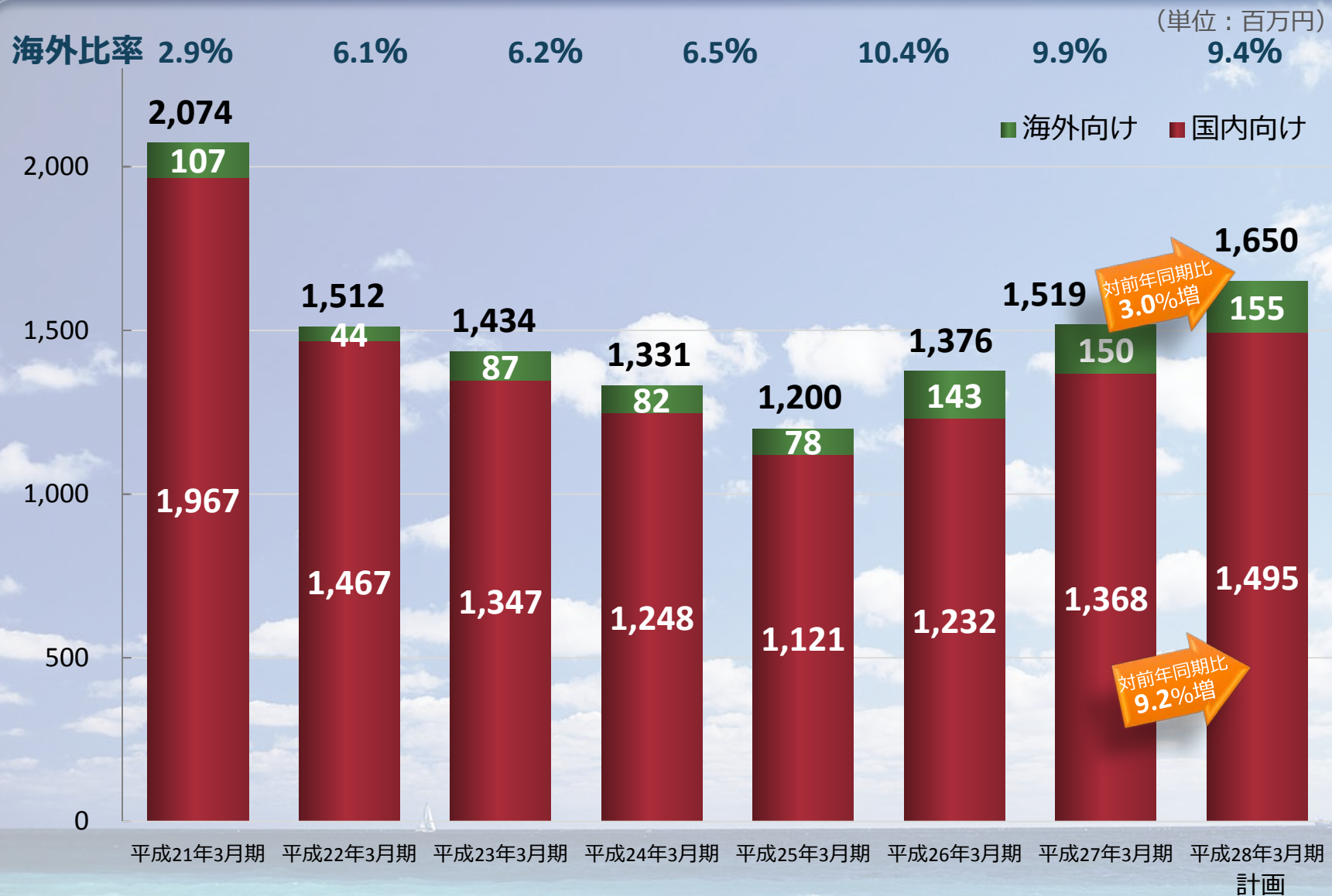


市場別売上高（半導体/FPD）

（単位：百万円）



販売先別売上高（国内/海外）



ご清聴ありがとうございました